

PlatiScan / ATElab

Schnelle Steckerprüfung

Als automatisiertes Inspektionssystem zur schnellen Prüfung von Steckern auf Backplanes und elektronischen Baugruppen konzipiert ist das »PlatiScan BackplaneTest« von PlatiScan (Vertrieb: ATElab). PlatiScan bildet das menschliche Vorgehen einer manuellen Sichtprüfung per Software nach und ist in der Lage, durch spezielle Algorithmen auch eine große Zahl von Steckern innerhalb kürzester Zeit umfassend zu prüfen.

Das kamerabasierte System prüft die Backplanes auf vorhandene, verbogene oder fehlende Pins sowie auf Stecker-Codierungen. Erkannte Fehler werden auf dem Bildschirm angezeigt oder als Text-Report ausgegeben. PlatiScan BackplaneTest ist in verschiedenen Konfigurationen als Stand-alone-System, zur Integration in ein Testsystem oder für einen vollautomatischen Inline-Betrieb erhältlich. (nw)

Halle 7, Stand 624

Heicks Industrieelektronik

Baugruppen hermetisch versiegeln

Zum Schutz von Baugruppen und Bauteilen wie BGAs oder QFPs ist die Parylenebeschichtung, wie sie der EMS-Dienstleister Heicks anbietet, eine interessante Alternative. Das Beschichtungsverfahren bietet mit einer gleichmäßigen Beschichtungsqualität eine hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit und isoliert die Bauelemente und Baugruppen wirksam gegen Feuchtigkeit, Korrosion, aggressive Medien

und flüssige Kohlenwasserstoffe. Parylene bildet eine Diffusionsbarriere gegen Gase und versiegelt auch gegen Metallstäube, Kriechströme und Kondenswasser. Parylene-beschichtete Baugruppen bestehen auch die hohen Anforderungen eines Salznebelprüfstands. Auskunft zum Verfahren und zur Beschichtungsdienstleistung erteilt Heicks auf der SMT/Hybrid/Packaging. (zu)

Halle 9, Stand 529

LaserJob

Alternative zu gerahmten Schablonen

Das Spannsystem LJ745 von LaserJob basiert auf der bewährten Spannstation mit einfachem Handling und ermöglicht Spannzüge >40 N/cm für alle Schablonenstärken, auch unter 100 µm, vergleichbar mit einer Schablone im Rahmen. Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, einen gleichmäßig hohen Spannzug in die Schablone einzubringen, unabhängig von der Schablonenstärke und Schablonengröße. Es können

sowohl Rahmengrößen 584 x 584 mm als auch 736 x 736 mm bis zu einer Schablonenstärke unter 100 µm eingesetzt werden. Durch die neue Spannrahmentechnologie wird die Stabilität der Schablone entscheidend erhöht und die Knickgefahr durch unsachgemäße Handhabung eliminiert. Das System ist eine kostengünstigere Alternative zu allen gerahmten Schablonen. (zu)

Halle 6, Stand 224